



מפעל UMC בטאיוואן.

יצרנית השבבים (UMC) Microelectronics United מתכוונת להרחיב את מוצרי תהליכי ה-28nm על ידי השקת צומתי HPC 28nm ו-Plus HPC 28nm, שיהיו זמינים ב-2018. יצרנית השבבים מתכונת גם להציג את תהליך ה-22nm ULP באמצע השנה הבאה.

שני התהליכים של UMC, HPC 28nm ו-Plus HPC 28nm, צפויים להיות זמינים אחרי 3-4 רבעונים, אמר הנשיא המשותף של החברה ג'ייסון וואנג במפגש משקיעים ב-26 ביולי. גרסה משופרת יותר של תהליך ה-28nm של UMC, ULP 22nm, תושק אף היא באמצע 2018, ציין וואנג.

למרות זאת, וואנג הזהיר שיהיה קיטון בעסקי ה-28nm HKMG של UMC במחצית השנייה של 2017. לגבי צומת ה-PolySiON 28nm של החברה, קיבולת הייצור של התהליך ממשיכה לפעול בנצילות מלאה. קיצוץ בהזמנות של שבבי HKMG 28nm מקוואלקום, וגם מעבר של כמה לקוחות לטכנולוגיות 16/14nm מתקדמות יותר, גרמו לקיטון בעסקי ה-28nm HKMG של UMC, לפי מקורות בענף.

בחודש פרוסות 40,000-7 הגיעה 28nm תהליכי בטכנולוגיית שלה הכוללת הייצור שקיבולת ציינה UMC כש-5,000 יחידות מיוצרות במפעל בשיאמן, סין. לחברה יש תוכניות להרחיב את קיבולת הייצור של תהליך ה-28nm במפעל בשיאמן ב-2018, אבל אמרה שההתקדמות בפועל תהיה תלויה בנסיבות השוק. החברה אמרה שקיבולת הייצור של טכנולוגיית תהליך ה-14nm היותר מתקדמת הגיעה ל-2,000 פרוסות בחודש. מתקדמות יותר תהליך וטכנולוגיות 10nm לגבי שלה התוכניות את פירטה לא UMC.

במפעלי הנצילות שיעורי ואילו, הקיבולת במלוא לעבוד ממשיכים אינטש 8 של הייצור שקווי הוסיפה UMC ה-12 אינטש של החברה הם בסביבות 85% כעת. החברה מצפה ששיעור נצילות הקיבולת הכולל שלה יהיה בין 90%-93% ברבעון השלישי.

בנוסף, UMC עדיין עוסקת בפיתוח של הדור הראשון של טכנולוגיית הייצור של DRAM 3Xnm עבור Fujian מוכנה תהיה שהיא והוסיפה הטאיוואנית השבבים יצרנית מסרה, הסינית Jin Hua Integrated Circuit כש-Hua Jin תתחיל להפעיל את מפעל ה-12 אינטש החדש שלה עד סוף 2018. UMC גם תעזור ל-Jin 2Xnm DRAM של הייצור טכנולוגיית של השני הדור את לפתח Hua

כתבות קודמות בנושא:

- [ננומטר 10-7 גם יבמ עם FinFET שותפות את מרחיבה UMC](#)
- [יישומים עבור ננומטר 28-ב-IP ה בתחום הפעולה שיתוף את מרחיבות UMC-ו ARM צרכניים ויישומים ניידים חסכוניים באנרגיה](#)

{loadposition content-related}

UMC מתכנת תהליכי 28HPC, 22ULP